## (19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

## 特許第6964582号

(P6964582)

(45) 発行日 令和3年11月10日(2021.11.10)

- (24) 登録日 令和3年10月21日 (2021.10.21)
- (51) Int.Cl. F I CO3B 37/018 (2006.01) CO3B 37/018 C

請求項の数 5 (全 36 頁)

(21) 出願番号 (86) (22) 出願日	特願2018-517578 (P2018-517578) 亚成28年10月5日 (2016-10-5)	(73)特許権者	首 397068274 コーニング インコーポルイテッド
(80)(22)山原口	$+ p_{2} 28 + 10 + 351 (2010, 10.3)$		
(65)公表番号	特表2018-535176 (P2018-535176A)		アメリカ合衆国 ニューヨーク州 148
(43) 公表日	平成30年11月29日 (2018.11.29)		31 コーニング リヴァーフロント プ
(86) 国際出願番号	PCT/US2016/055408		ラザ 1
(87) 国際公開番号	W02017/062400	(74) 代理人	100073184
(87) 国際公開日	平成29年4月13日 (2017.4.13)		弁理士 柳田 征史
審査請求日	令和1年10月7日(2019.10.7)	(74)代理人	100175042
(31) 優先権主張番号	62/238, 370		弁理士 高橋 秀明
(32) 優先日	平成27年10月7日 (2015.10.7)	(72)発明者	クルジンスキー,ポール アンドリュー
(33) 優先権主張国・地域又は機関			アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 2
	米国 (US)		8443 ハムステッド ケンパー ロー
			下 313

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光ファイバプリフォーム中の割れを防止するための方法、及び上記方法によって得られる光ファ イバプリフォーム

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

<u>内</u>部キャビティを取り囲<u>む多</u>孔性クラッドガラス層を含<u>み、第</u>1の熱膨張係数を有する 第1の材料からなる多孔性スートクラッドモノリス;

- 前記内部キャビティ内に位置決めされた部分を有し、<u>前記第1の熱膨張係数と異なる</u>第 2の熱膨張係数を有する第2の材料からなる第1のガラス本体;及び
- 前記内部キャビティ内に位置決めされた部分を有し、前記第2の熱膨張係数と異なる第 3の熱膨張係数を有する第3の材料からなる第2のガラス本体
- を備え、

<u>前記第2のガラス本体は、前記多孔性スートクラッドモノリスの前記内部キャビティ内</u> <sup>10</sup> で、前記第1のガラス本体の端部表面に直接的に接触する、コア クラッド組立体。

【請求項2】

前記第1の材料はシリカを含み、

前記第2の材料は、ドーパントを含有するシリカを含む、請求項1に記載のコア クラッド組立体。

【請求項3】

前記第1のガラス本体は、少なくとも0.70のコア クラッド比を有する、請求項1 又は2に記載のコア クラッド組立体。

【請求項4】

前記第2の熱膨張係数は、前記第1の熱膨張係数と前記第3の熱膨張係数のいずれより 20

も大きい、請求項1~3のいずれか1項に記載のコア クラッド組立体。

【請求項5】

前記内部キャビティ内に<u>前記第1のガラス本体の端部表面に直接的に接触するように</u>位 置決めされる第3のガラス本体を更に備え、

前記第3のガラス本体は、<u>前記第2の熱膨張係数と異なる</u>第4の熱膨張係数を有する第4の材料を含<u>む</u>、請求項1~4のいずれか1項に記載のコア クラッド組立体。 【発明の詳細な説明】

【優先権】

[0001]

本出願は、米国特許法第119条の下で、2015年10月7日出願の米国仮特許出願 10 第62/238,370号の優先権の利益を主張するものであり、上記仮特許出願の内容 は信頼できるものであり、その全体が参照により本出願に援用される。

【技術分野】

【0002】

本記載は、光ファイバの作製に使用されるプリフォームに関する。より詳細には、本記 載は、ケーン・イン・スート(cane in soot)プロセスで作製される光ファ イバプリフォームに関する。より詳細には、本記載は、コア クラッド比が大きい、割れ のない光ファイバプリフォームに関する。

【背景技術】

[0003]

光通信システムは、高伝送速度及び高帯域幅を提供するため、データ伝送に関してます ます重要となっている。光通信システムの成功は、データ伝送システムにおいて使用され る光ファイバの品質に大きく依存する。光ファイバは、光データ信号を、高い忠実度及び 低い減衰で伝送する必要がある。

[0004]

光ファイバは、プリフォームからファイバをドロー形成することによって作製される。 プリフォームは、典型的にはドーパントのレベル又はタイプが異なるシリカガラスの一連 の同心領域を含む、固結済みシリカガラスである。ファイバプリフォーム中のドーパント の空間分布、濃度及び / 又はタイプの制御は、屈折率が異なる複数の領域を生成する。屈 折率の差は、プリフォームからドロー形成されたファイバにおいて明白であり、光ファイ バの異なる複数の機能領域(例えば、コア対クラッド、低屈折率窪み、調整された屈折率 プロファイル)を規定する。

【0005】

光ファイバプリフォームを製造するための1つの従来の方法は、外側蒸着プロセスであ り、これは、シリカ(又はドープシリカ)スートをシリカ(又はドープシリカ)ケーン( cane)上に堆積させることを必要とする。上記ケーンは、概ね円筒形の幾何学的形状 を有する、完全に固結したガラスであり、ファイバプリフォームの中心部分となる。上記 ケーンは、最終的にプリフォームからドロー形成されるファイバの高屈折率コア領域とし て望ましい組成を有する(そのため、コアケーンと呼ばれることが多い)。上記シリカス ートはケーンを取り囲むことができ、また単一の組成物の単一の層又は組成が異なる一連 の複数の層として堆積させることができ、上記1つ以上の層の組成は、最終的にプリフォ ームからドロー形成される繊維のクラッド領域に所望の屈折率プロファイルを提供するよ う設計される。上記1つ以上のスートクラッド層は典型的には、ドーパントの濃度又はタ イプが異なる、複数の非ドープシリカ及びドープシリカ層を含む。

[0006]

クラッドスートは通常、1つ以上の前駆材料の火炎反応によって製造される。上記火炎 反応は、火炎加水分解又は火炎燃焼であってよい。火炎加水分解では、水が反応物として 存在し、スート前駆材料と反応してクラッドスートを形成する。火炎燃焼では、水は反応 物ではないが、副産物として生成される場合がある。シリカスートのための一般的な前駆 材料としては、SiCl<sub>4</sub>及びOMCTS(オクタメチルシクロテトラシロキサン)が挙

30

20

げられる。スート堆積反応中に水が存在することにより、シリカスート中、並びにケーン の表面及び表面付近領域における、OHの高い濃度がもたらされ得る。OH基の濃度を低 減するために、スート堆積後に脱水ステップを実施する。上記脱水ステップでは、スート 及びケーンを、OHを除去するように作用する脱水剤(例えばC1<sub>2</sub>)に曝露する。堆積 されたままの状態のスートの高い多孔率は、この脱水ステップにおけるスート層からのO Hの除去を促進する。しかしながら、ケーンの高密度特性は、脱水剤によるケーンへの浸 透を阻害し、プリフォームのケーン部分に有意量のOHが残る場合がある。プリフォーム 中のOHの存在は、プリフォームからドロー形成されたファイバ中に高濃度のOHをもた らし、また、約1350nm~約1425mmに亘る広いOH吸収帯域により、1380 nm又はその付近の光信号に関する高いファイバ減衰損失をもたらす。 【0007】

伝送ファイバ中の光信号は主にコア領域に閉じ込められるため、ファイバコア中のOH 濃度を最小化することが特に重要であり、これはコアケーン(ファイバプリフォームの、 そこからファイバコアがドロー形成される領域)中のOH濃度の最小化を必要とする。コ アケーン中のOHの存在を最小化するために使用される典型的戦略は、高屈折率領域をコ アケーンの中心へと局在化することである。コアケーンの高屈折率領域は典型的には、ア ップドープシリカ(例えばGeドープシリカ)から形成され、アップドープの領域はコア ケーンの中心部分に限定される。目的は、コアケーンの外側径方向境界から十分な距離に アップドープ領域を維持して、高屈折率をOH汚染から保護することである。コアケーン の、中心のアップドープ領域と外側径方向境界との間の部分は、コアケーンの表面上に形 成されるOHの拡散を阻止するためのバッファとして作用する。コアケーンは固結した状 態であるため、コアケーンの表面から中心へのOHの拡散は、現実的なタイムスケールで は発生せず、OHはコアケーンの表面及び表面付近領域に局在化される。コアケーンの内 部の高屈折率領域を、表面付近領域から十分な距離に位置決めすることにより、高屈折率 領域内のOHの存在を最小化でき、OH吸収による減衰損失が回避される。

典型的には、高屈折率領域はコアケーンの中心に存在し、高屈折率領域の径方向範囲は 、コアケーンのコア クラッド比によって定量化できる。コア クラッド比は、コアケー ンの外径に対する高屈折率領域の半径の比として定義される。例えば0.5のコア クラ ッド比は、コアケーンの高屈折率(アップドープ)領域の半径がコアケーンの総半径の半 分であることを意味する。従来の外側蒸着プロセスでは、コア クラッド比を小さく(例 えば<0.33に)維持することによって、プリフォームのアップドープ内、及び上記プ リフォームからドロー形成されたファイバのコア中の、OHの存在を最小化する。しかし ながら、コア クラッド比が小さいコアケーンの利用は、アップドープ領域の寸法を超え てコアケーンを拡大するために必要な時間及び材料のコストを理由として、加工の観点か ら非経済的である。

【 0 0 0 9 】

ケーン・イン・スートプロセスは、水に対するコアケーンの曝露を回避する、ファイバ プリフォームを作製するための代替的な方法である。ケーン・イン・スートプロセスでは 、コアケーン及びスートクラッドモノリスを別個のプロセスで形成した後、接合してコア クラッド組立体を形成し、これを固結させてプリフォームを形成する。スートクラッド モノリスは多孔性であり、中にコアケーンが配置される内部キャビティを含む。固結によ り多孔性スートクラッドモノリスを高密度化し、またコアケーンをスートクラッドモノリ スに融着させて、ファイバプリフォームとして使用できる一体型の本体を形成する。コア ケーン及びスートクラッドモノリスが独立して形成されるため、コアケーンは、クラッド スート堆積プロセスに存在する水反応物又は副産物に曝露されない。コアケーンは、水が 存在しない環境で形成、脱水及び固結できる。同様に、スートクラッドモノリスは、多孔 性の状態のまま堆積及び脱水でき、これにより、コアケーンとスートクラッドモノリスと の接合前に〇日を本質的に排除できる。多孔性スートクラッドモノリスの内部キャビティ へのコアケーンの挿入は、水の不在下で行われる。従って、コアケーンの高屈折率領域の

10

20

30

組み込みに関する課題は緩和され、低減衰のファイバを製造できる。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0010]

コアケーンが水から保護されるため、ケーン・イン・スートプロセスは、コア クラッド比が大きいコアケーンの使用を可能とすることによって、プロセス効率を改善する。しかしながら、ケース・イン・スートプロセスの実際の実装により、コア クラッド比が大きいコアケーンからケース・イン・スートプロセスで作製されたプリフォーム中に欠陥が形成されることが明らかになっている。これらの欠陥は、ケース・イン・スートプロセス中の固結後のプリフォームの冷却中に現れる応力に由来するものであると考えられている。コア クラッド比が大きいコアケーンから、欠陥を有しないファイバプリフォームを形成できる、ケース・イン・スートプロセスの開発が望まれている。

10

【課題を解決するための手段】

[0011]

本開示は:コア クラッド比が大きいコアケーンから形成された光ファイバプリフォーム;中間コア クラッド組立体;並びに上記プリフォーム及び上記コア クラッド組立体 の作製方法を提供する。上記プリフォームは、キャッピング済みコアケーンを用いて作製 される。キャッピング材料は、コアケーンの熱膨張係数より低く、かつケース・イン・ス ートプロセス中の周囲のスートクラッドモノリスの熱膨張係数により密接に一致する熱膨 張係数を有する。キャップの存在により、コアケーン及びクラッド材料の異なる熱膨張か ら発生する応力が低減され、欠陥の濃度が低く、かつファイバのドロー形成中の破損の蓋 然性が低いプリフォームがもたらされる。

20

40

[0012]

本開示は:

多孔性スートクラッドモノリスであって、上記多孔性スートクラッドモノリスは、内部 キャビティを取り囲む第1の多孔性クラッドガラス層を含み、上記多孔性スートクラッド モノリスは、第1の熱膨張係数を有する第1の材料を含む、多孔性スートクラッドモノリ ス;

上記内部キャビティ内に位置決めされた部分を有する第1のガラス本体であって、上記 第1のガラス本体は、第2の熱膨張係数を有する第2の材料を含み、上記第2の熱膨張係 <sup>30</sup> 数は上記第1の熱膨張係数と異なる、第1のガラス本体;及び

上記内部キャビティ内に位置決めされた部分を有する第2のガラス本体であって、上記 第2のガラス本体は、第3の熱膨張係数を有する第3の材料を含み、上記第3の熱膨張係 数は上記第2の熱膨張係数と異なる、第2のガラス本体

を備える、コア クラッド組立体を、その範囲に含む。

[0013]

本開示は:

クラッドで取り囲まれたキャッピング済みコアケーンであって、上記キャッピング済みコ アケーンは、コアケーンの第1の端部表面と接触する第1のキャップを備え、上記コアケ ーンはドープシリカを含み、かつ少なくとも0.7のコア クラッド比を有し、上記プリ フォームはコーナ領域を含み、上記コーナ領域は、上記キャッピング済みコアケーンと、 上記クラッドと、気体との間の界面を含み、上記コーナ領域は、100MPa未満の径方 向引張応力を有する、キャッピング済みコアケーン

を備える、光ファイバプリフォームを、その範囲に含む。

[0014]

本開示は:

多孔性スートクラッドモノリスであって、上記スートクラッドモノリスは第1の多孔性 ガラスクラッド層を含み、かつ内部キャビティを有する、多孔性スートクラッドモノリス を提供するステップ;及び

キャッピング済みコアケーンを上記内部キャビティに挿入して、コア クラッド組立体 50

を形成するステップであって、上記キャッピング済みコアケーンは、コアケーンと接触す る第1のキャップを含み、上記第1のキャップは、第1の熱膨張係数を有する第1の材料 を含み、上記コアケーンは、第2の熱膨張係数を有する第2の材料を含み、上記第2の熱 膨張係数は上記第1の熱膨張係数と異なる、ステップ

を含む、光ファイバの製造方法を、その範囲に含む。

**[**0015**]** 

本開示は:

多孔性スートクラッドモノリスを提供するステップであって、上記スートクラッドモノ リスは第1の多孔性ガラスクラッド層を含み、内部キャビティを有する、ステップ;

第1のキャップを上記内部キャビティに挿入するステップであって、上記第1のキャッ <sup>10</sup> プは、第1の熱膨張係数を有する第1の材料を含む、ステップ;及び

コアケーンを上記内部キャビティに挿入するステップであって、上記コアケーンは、第 2の熱膨張係数を有する第2の材料を含み、上記第2の熱膨張係数は上記第1の熱膨張係 数と異なる、ステップ

を含む、光ファイバを製造する方法を、その範囲に含む。

[0016]

更なる特徴及び利点は、以下の「発明を実施するための形態」に記載されており、また その一部は、当業者には本説明から容易に明らかとなるか、又は本説明及び請求項並びに 添付の図面に記載される実施形態を実施することによって認識されるだろう。

【 0 0 1 7 】

以上の概説及び以下の詳細な説明は単なる例示であり、請求項の性質及び特徴を理解す るための概観又は枠組みを提供することを意図したものであることを理解されたい。

**[**0018**]** 

添付の図面は、更なる理解を提供するために含まれているものであり、本明細書に組み 込まれて本明細書の一部を構成する。これらの図面は、本記載の選択された態様を例示す るものであり、本明細書と合わせて、本記載が包含する方法の原理及び操作、製品並びに 組成物を説明する役割を果たす。図面中に示されている特徴は、本説明の選択された実施 形態を例示するものであり、必ずしも適切な縮尺で図示されていない。

【0019】

本明細書は、本説明の主題を特定して指摘し別個に請求する請求項で締め括られるが、 本明細書は、添付の図面と併せて解釈すれば、以下の説明から比較的良好に理解されるだ ろう。

【図面の簡単な説明】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 

【図1A】低曲げ損失光ファイバを作製するためのアップドープ(up doped)オ ーバクラッドプロファイルを示す図

【図1B】低曲げ損失光ファイバを作製するためのトレンチを有するアップドープオーバ ークラッドプロファイルを示す図

【図2A】図1Aに示す光ファイバの例示的な相対屈折率プロファイルであり、ここでコ アはr<sub>0</sub>からr<sub>1</sub>まで延在し、屈折率 <sub>1</sub>を有し、内側クラッドはr<sub>1</sub>からr<sub>2</sub>まで延在 <sup>4</sup> し、屈折率 <sub>2</sub>を有し、オーバクラッドはr<sub>2</sub>からr<sub>3</sub>まで延在し、屈折率 <sub>3</sub>を有する 【図2B】図1Bに示す光ファイバの例示的な相対屈折率プロファイルであり、ここでコ アはr<sub>0</sub>からr<sub>1</sub>まで延在し、屈折率 <sub>1</sub>を有し、内側クラッドはr<sub>1</sub>からr<sub>2</sub>まで延在 し、屈折率 <sub>2</sub>を有し、低屈折率材料のトレンチはr<sub>2</sub>からr<sub>4</sub>まで延在し、屈折率 <sub>4</sub> を有し、オーバクラッドはr<sub>4</sub>からr<sub>3</sub>まで延在し、屈折率 <sub>3</sub>を有する

【図3】本発明の実施形態による方法を用いて形成されたコアスートプリフォームの正面 図

【図4】ベイトロッド上へのスート層の堆積

【図5】図4に示すスート層上への第2のスート層の堆積

【図6】図5に示すスート層上への第3のスート層の堆積

20

(6)

【図7】3層スートクラッドモノリスの内部キャビティに挿入された、固結済みコアケー ンを含む、コア クラッド組立体の加工 【図8】図7に示すコア クラッド組立体から形成されたファイバプリフォーム 【図9(a)-(c)】ケーン・イン・スートプロセスによって調製されたファイバプリ フォーム 【図10】Geドープシリカ、非ドープシリカ及びFドープシリカガラスの熱膨張係数 【図11】Geドープシリカ及び非ドープシリカクラッドを有するプリフォームの熱膨張 係数 【図12】ケーン・イン・スートプロセスで作製された固結済みファイバプリフォーム中 10 のコアケーンの端部表面付近における、径方向引張応力分布 【図13】コーナ半径に対する径方向引張応力の依存 【図14】欠陥を呈するコアケーンの画像 【図15】キャッピング済みコアケーン 【図16】キャッピング済みコアケーンを形成するための一方法 【図17】予備製作されたキャッピング済みコアケーンをスートクラッドモノリスの内部 キャビティに挿入することによる、コア クラッド組立体の形成 【図18】キャッピング済みコアケーン及びスートクラッドモノリスを有するコア クラ ッド組立体を形成するための、代替実施形態 【図19】スートクラッドモノリスの内部キャビティ内にキャッピング済みコアケーンを 20 有する、コア クラッド組立体の固結 【図20】GeO,ドープシリカコアケーンの端部表面に存在するSiO,キャップの高 さ(厚さ)に対する、固結済みプリフォームのコーナ領域における径方向引張応力の依存 【図21】キャッピング済みコアケーンを含むプリフォームの図 【図22】キャッピング済みコアケーンを用いて作製されたプリフォーム内の径方向引張 応力分布 【発明を実施するための形態】 [0021]図面に示されている実施形態は本質的に例示であり、「発明を実施するための形態」又 は請求項の範囲を限定することを意図したものではない。可能な限り、図面全体を通して 30 、同一又は同様の特徴部分を指すために同一の参照番号を使用する。 [0022]これより、本説明の例示的実施形態について詳細に言及する。 [0023]本明細書中で使用される場合、用語「スート(soot)」は、SiO₂又はドープS iO , 粒子を意味し;個々のスート粒子は一般に、直径0.01~10マイクロメートル のサイズを有する。「スートプリフォーム(soot preform)」は、ある開気 孔率を有する、複数のスート粒子からなる物品を意味する。用語「多孔性スート(por ous soot)」及び「多孔性ガラス(porous glass)」は、本明細書 では相互交換可能なものとして使用される。用語「コア部分(core portion 40 )」又は「コアケーン(core cane)」は、固結済みガラスを指し、シリカ又は、 ドープシリカガラスで構成されてよい。用語「固結済みガラス(consolidate d glass)」は、閉気孔状態ガラスを指す。いくつかの実施形態では、このガラス は空所を有しない。用語「スート ガラス変形(soot to glass tran sformation)」は、多孔性ガラス状態から閉気孔状態へ進むプロセスを指す。 以下に更に十分に説明するように、スート ガラス変形プロセスは、脱水ステップ、ドー プステップ、及び焼結ステップを含んでよい。いくつかの実施形態では、ガラスはこのス ート ガラス変形プロセスにおいて、空所を有しないものとなる。用語「光ファイバプリ フォーム(又は固結済みプリフォーム(consolidated preform)、 焼結済みプリフォーム(sintered preform)又はブランク(blank ))」は、そこから光ファイバをドロー形成できるガラス物品を指す。 50

等式1

【0024】

本明細書中で使用される場合、「アップドーパント(up dopant)」は、純粋 なドープされていないSiO₂ガラスに対して、シリカ(「SiO₂」)ガラスの屈折率 を上昇させるドーパントを指し;即ちアップドーパントは、ガラス反射率の上昇を引き起 こす。用語「ダウンドーパント(down dopant)」は、純粋なドープされてい ないSiO₂ガラスに対して、シリカガラスの屈折率を低下させるドーパントを指す。ア ップドーパントの非限定的な例は、Ge、A1、P、Ti、C1及びBrである。ダウン ドーパントの非限定的な例は、非周期的空所、フッ素及びホウ素である。プリフォーム及 び / 又はファイバ中のドーパント濃度は、本明細書では重量ベースで表される(例えば、 重量割合でのppm、ppm(重量)、重量パーセント、重量%)。

【0025】

本明細書中で使用される場合、「相対屈折率(relative refractiv e index)」は、等式1:

【0026】

【数1】

$$\Delta_i(r_i)\% = 100 \frac{\left(n_i^2 - n_{ref}^2\right)}{2n_i^2}$$

【 0 0 2 7 】

で定義され、ここで n<sub>i</sub>は、そうでないことが明記されていない限り、半径 r<sub>i</sub>における 20 屈折率であり、また n<sub>ref</sub>は、そうでないことが明記されていない限り、純シリカガラ スの屈折率である。

【0028】

本明細書中で使用される場合、「脱水雰囲気(dehydration atmosp here)」又は「乾燥雰囲気(drying atmosphere)」は、「乾燥ガ ス(drying gas)」を含有するガス雰囲気を指し、また本明細書において使用 される場合、「乾燥ガス」は、所望の、かつ好適な乾燥剤を含むガス又はガス混合物を指 す。乾燥剤は、スートプリフォーム中に存在する水及び / 又はヒドロキシルイオンを除去 することによって作用する、乾燥用の化合物である。例示的な乾燥剤としては:CCl<sub>4</sub> 、Cl<sub>2</sub>、Br<sub>2</sub>、SOCl<sub>2</sub>、CO及びSiCl<sub>4</sub>が挙げられるが、これらに限定され ない。例えば、限定するものではないが、「乾燥ガス」はHe、HeとN<sub>2</sub>との混合物、 並びにCl<sub>2</sub>、CCl<sub>4</sub>、SiCl<sub>4</sub>及び / 又は他の乾燥剤であってよい。いくつかの実 施形態では、乾燥ガスは、Cl<sub>2</sub>及びSiCl<sub>4</sub>からなる群から選択される乾燥剤を含む 。ガス相中の構成成分の濃度は、本明細書では体積ベースで表される(例えば、体積割合 でのppm、ppm(体積)、体積パーセント、体積%)。

本明細書中で使用される場合、「固結(consolidation)」又は「スート ガラス固結(soot to glass consolidation)」は、乾燥 、ドープ及び焼結等の様々なプロセスステップを実施するために、スートプリフォームを 少なくとも約800 の温度まで加熱するステップを指す。一実施形態では、固結は、8 00 ~1550 の温度範囲にわたって行われる。1050 未満の温度においてスー トプリフォームを加熱する、固結のステージは、本明細書では固結の「予備加熱ステップ (pre heat step又はpre heating step)」と呼ばれる場 合もある。予備加熱ステップは、800 ~1050 の範囲の温度で行ってよい。一実 施形態では、乾燥及びドープは、固結の予備加熱ステップにおいて完了する。スートプリ フォームを1050 ~1300 の温度まで加熱する、固結のステージは、本明細書で は固結の「中間加熱ステップ(intermediate heat step又はin termediate heating step)」と呼ばれる場合もある。予備加熱 ステップは、単一のステップに組み合わせてよく、又は順次実施してよい。 スートプリフォームを少なくとも1300 の温度まで加熱する、固結のステージは、本 10

30

40

明細書では固結の「焼結ステップ(sinter step又はsintering s tep)」と呼ばれる場合もある。焼結ステップは、1300 ~1550 の範囲の温 度、又は1550 超の温度において行ってよい。ガラスを形成するため(例えばガラス 質シリカ若しくは溶融シリカ、又はドープドープされた溶融シリカを形成するため)の、 スートの高密度化は、主に焼結ステップで行われることが予想される(ただし中間加熱ス テップ及び/又は予備加熱ステップにおいて行ってもよい)。塩素ガス又は塩素含有ドー パント前駆体を用いて、プリフォームを塩素でドープするステップは、予備加熱ステップ 、中間加熱ステップ及び焼結ステップのうちの1つ以上の間に行ってよい。

【0030】

本明細書において使用される場合、「クラッド(cladding)」は、光ファイバ <sup>10</sup> コアを取り囲み、かつ上記コアの外縁部から上記光ファイバの外縁部まで延在する、1つ 以上のガラス層を指し、用語「オーバクラッド(overclad)」又は「外側クラッ ド(outer clad)」及び同様の用語は、光ファイバ上の最後のクラッド層(最 外部の、最も径方向に離れたクラッド層)を指す。

[0031]

本明細書では、コア クラッド比は、コアケーンの外径に対する、コアケーンの高屈折 率領域の半径の比として定義される。

【0032】

本明細書中で使用される場合、「接触(contact)」は、直接的な接触又は間接 的な接触を指す。直接的な接触は、介在材料が存在しない接触を指し、間接的な接触は、 1つ以上の介在材料を介した接触を指す。直接的に接触した要素は互いに接している。間 接的に接触した要素は互いに接していないが、介在材料と接している。接触した要素の接 合は、しっかりしたものであってもなくてもよい。

【0033】

本開示について、添付の図面を参照して以下により十分に説明する。しかしながら本開 示は他の多数の形態で具現化でき、本明細書に記載の実施形態に限定されるものとして解 釈してはならない。寧ろこれらの実施形態を提供することにより、本開示は徹底的かつ完 全なものとなり、本発明の範囲を当業者に十分に伝達するものとなる。全体を通して同様 の番号は同様の要素を指す。

【0034】

光ファイバは一般に、光の伝送のためのコアファイバと、コア内の伝送された光を保持 して、距離による伝送損失を低減することを目的とする、1つ以上のクラッド層とからな る。例示的な段階的屈折率光ファイバを、図1Aに示す。光ファイバ11aは、コア10 、内側クラッド12a及び外側クラッド12bを含む。図1Aの光ファイバ11aに関す る相対屈折率プロファイルを図2Aに示す。コア10は、コア中心r<sub>0</sub>からコア外縁部r 1まで径方向に延在し、屈折率 1を有する。内側クラッド12aは、コア外縁部r<sub>1</sub>か ら径方向距離r<sub>2</sub>まで径方向に延在し、屈折率 2を有する。外側クラッド12bは、r 2から、r<sub>3</sub>にあるファイバの外縁部まで径方向に延在し、屈折率 3を有する。

本明細書の記載から、本発明に従って代替的な好適な構成の光ファイバを形成できるこ 40 とが理解されるだろう。いくつかの実施形態では、内側クラッド領域と外側クラッド領域 との間に、12tで示されるトレンチ領域が存在する。トレンチ領域は、曲げ損失に対す る光ファイバの感受性を低減する。このようなプロファイルの例を、光ファイバ11bと して図1Bに示し、この光ファイバ11bは、図2Bに示す相対屈折率プロファイルを有 する。図2Bでは、コア10は、コア中心roからコア外縁部r1まで径方向に延在し、 屈折率 1を有する。内側クラッド12aは、コア外縁部r1から径方向距離r2まで径 方向に延在し、屈折率 2を有する。トレンチ領域12tは、r2からr4まで径方向に 延在し、屈折率 4を有する。外側クラッド12bは、r4から、r3にあるファイバの 外縁部まで径方向に延在し、屈折率 3を有する。外側クラッド領域の屈折率 3は、外 側クラッド領域のアップドープの結果として、内側クラッド領域の屈折率 2より高い。 50

30

トレンチ領域12tの屈折率 4は、上記領域をダウンドーパントでドープすることによって達成される。

【0036】

本説明は:コア クラッド比が大きいコアケーンから形成された光ファイバプリフォーム;上記光ファイバプリフォームの作製に使用される中間コア クラッド組立体;上記プリフォームを作製するためのプロセス;及び上記プリフォームからドロー形成された光ファイバを提供する。

【0037】

光ファイバプリフォームは、コアケーンと、上記コアケーンを取り囲む1つ以上のクラ ッド層とを含む。プリフォームは、コア クラッド組立体を加工することによって形成さ れる。加工は、コア クラッド組立体の脱水、ドープ及び/又は焼結を含んでよい。コア クラッド組立体は、コアケーン及びスートクラッドモノリスを含み、ここで上記スート クラッドモノリスは、ト記コアケーンとは独立して形成され 1つ以上の名利性クラッド

10

クラッド組立体は、コアケーン及びスートクラッドモノリスを含み、ここで上記スート クラッドモノリスは、上記コアケーンとは独立して形成され、1つ以上の多孔性クラッド 層を含む。スートクラッドモノリスは、内部キャビティを含んでよく、コア クラッド組 立体は、コアを上記内部キャビティに挿入することによって形成してよい。焼結は、コア クラッド組立体の多孔性クラッド層を固結して高密度化されたクラッド層を達成し、上 記高密度化されたクラッド層はコアケーンに融合して、光ファイバプリフォームを形成す る。

【0038】

20 シファイバプリフォームは、欠陥の形成を最小化するケーン・イン・スートプロセスか ら作製される。光ファイバプリフォームは本質的に欠陥を含まず、ファイバドロー形成温 度への再加熱に、割れを発生させることなく耐えることができる。ケーン・イン・スート プロセスでは、コアケーン及びスートクラッドモノリスは互いに独立して形成される。コ アケーンは、固結済みガラス本体である。スートクラッドモノリスは多孔性であり、内部 キャビティを含む。コアケーンの少なくとも一部分を内部キャビティに挿入して、コア クラッド組立体を形成する。コア クラッド組立体は中間構造体であり、これを後に固結 させて光ファイバプリフォームを形成する。

【0039】

コアケーンの製作は、コアスートプリフォームの形成で開始できる。図1は、コアスー トプリフォームが形成される。図1は、ハンドル13を有する例示的なコアスートプリフ オーム8を示す。コアスートプリフォーム8は、化学蒸着(chemical vapo r deposition:CVD)(例えば外側蒸着(outside vapor deposition:OVD)、軸蒸着(vapor axial depositi on:VAD)、改質化学蒸着(modified chemical vapor d eposition:MCVD)、プラズマ化学蒸着(plasma chemical vapor deposition:PCVD))、又はゾル ゲル加工若しくは火炎 加水分解といった他のいずれの好適な技法等の、いずれの好適な方法を用いて形成してよ い。コアスートプリフォーム8は、純粋なシリカ又はドープシリカ(例えば、ゲルマニア 、ホウ素、フッ素、アルミニウム、チタン、リン及び/若しくは塩素を含むがこれらに限 定されない、1つ若しくは複数の好適なドーパントでドープされたシリカ)から形成して よい。ドープを使用して、コアスートプリフォームの屈折率を制御してよい。コアケーン の屈折率プロファイルは、定常プロファイル、段階的屈折率プロファイル、又は単調変化 性プロファイル(例えば プロファイル若しくはスーパーガウス型プロファイル)であ ってよい。コアスートプリフォームは、単層又は複層体として形成してよく、ここで上記 1つ以上の層はドープされてよく、ドープされていなくてもよく、またドープされている 場合は、上記1つ以上の層は、ドーパントのタイプ、濃度又は分布について違いを含んで いてよい。コアスートプリフォーム8は、複数の隙間を画定する多孔性構造体である。コ アスートプリフォーム8は、その全長に亘って延在する通路を含んでよく、上記通路から 、堆積装置のマンドレルが除去されている。いくつかの実施形態によると、コアスートプ リフォーム8の密度は約1.0g/cc以下、好ましくは約0.7g/cc以下、より好

30

ましくは約0.6g/cc以下である。

[0040]

コアスートプリフォーム8を固結させて、固結済みコアガラスプリフォームを形成し、 上記固結済みコアガラスプリフォームをドロー形成して、コアケーンを形成する。コアス ートプリフォーム8の固結は焼結を含み、また乾燥及び/又はドープといった他のプロセ スステップを含んでよい。コアスートプリフォーム8の固結は、本明細書に記載の方法に 適合するいずれの好適な又は望ましいプロセス又はパラメータを採用してよい。コアスー トプリフォーム8の固結及び固結済みコアスートプリフォームのドロー形成に好適な装置 は、当業者には公知である。

**[**0041**]** 

スートクラッドモノリスを、コアケーンとは独立して形成する。スートクラッドモノリ スを、コアケーンとは独立して形成することによって、コアケーンは、スートクラッドの 堆積反応又は堆積後加工における反応物又は副産物として存在する水に曝露されない。こ れはコアケーンの再湿潤化を防止し、ファイバプリフォームの、及びプリフォームからド ロー形成されたファイバ中の、ヒドロキシル含有量の削減につながる。結果として、ヒド ロキシル吸収による1380nmにおける減衰が大幅に低減される。

【0042】

スートクラッドモノリスは、シリカスート又はドープシリカスートの1つ以上の層を基 材上に堆積させ、上記基材を除去してスートクラッドモノリスを提供することによって形 成してよい。上記基材は、ベイトロッドであってよい。クラッドスート(又はその層)は 、純粋なシリカ、又はドープシリカ(例えば、ゲルマニア、ホウ素、フッ素、アルミニウ ム、チタン、リン及び / 若しくは塩素を含むがこれらに限定されない、1つ若しくは複数 の好適なドーパントでドープされたシリカ)で形成してよい。上述のように、クラッドス ートは、ドープ及び屈折率が異なる複数の層を含んでよく、これにより、図2A及び2B に示されているもののような、複数のクラッド領域を含むファイバ屈折率プロファイルが もたらされる。

【0043】

以下の議論では、3つの多孔性スートクラッド層を有するスートクラッド層の製作について記載する。しかしながら、概説される手順は、いずれの数の多孔性スートクラッド層 を有するスートクラッドモノリスに広く適用可能であることを認識されたい。 【0044】

図4は、ベイトロッド120上のシリカ系スート層112の堆積を示す。シリカ系ガラ ススートは、SiCl<sub>4</sub>又はオクタメチルシクロテトラシロキサン(OMCTS)といっ た気相シリカ系ガラス前駆体材料をバーナ122に供給することによって形成される。ガ スを供給されたバーナ122に、H<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、D<sub>2</sub>(重水素)、CD<sub>4</sub>又はCO等の燃 料を提供する。バーナ122に酸素も供給し、燃料及び酸素を燃焼させて、火炎126を 生成する。いくつかの実施形態では、気相シリカ系ガラス前駆体材料はSiCl<sub>4</sub>であり 、ガスを供給されたバーナ122には、堆積させたシリカ系ガラススート中の残留OHの 量を制限するために、D<sub>2</sub>、CD<sub>4</sub>又はCOといった非水素化燃料を供給する。気相シリ カ系ガラス前駆体材料は、約4L/分~約10L/分の流量でバーナへと送達してよく、 燃料は、約10L/分~約40L/分の流量でバーナに供給してよい。 【0045】

気相シリカ系ガラス前駆体材料は、火炎126中で反応して、シリカ系ガラススート1 28を産生し、これは、ベイトロッドが回転するに従って、ベイトロッド120上にスー ト層112として堆積される。回転速度は、約20rpm~約400rpm、又は30r pm~約100rpmであってよい。スート層112は、非ドープシリカと同一の、非ド ープシリカより高い、又は非ドープシリカより低い屈折率を有してよい。高い又は低い屈 折率は、アップドーパント又はダウンドーパント前駆体をバーナ122に供給することに よって達成できる。スート層112は、単層スートクラッドモノリスを構成してよく、又 は多層スートクラッドモノリスの最内(最小半径)層を構成してよい。ガスを供給された 10

20



バーナ122の火炎126は、ベイトロッドが回転するに従って、矢印124で示される ようなベイトロッド120の軸方向長さに沿って前後に横断し、これにより、シリカ系ガ ラススートが構成され、ベイトロッド120上にスート層112が形成される。 【0046】

(11)

図5は、スート層112上のスート層116の堆積を示す。スート層116は、スート 層112と同様の方法で形成できる。例えば、SiCl<sub>4</sub>又はOMCTSといった気相シ リカ系ガラス前駆体材料をバーナ122に供給し、火炎126中で反応させて、シリカ系 ガラススートを形成でき、これは、ベイトロッドが回転するに従ってスート層112上に スート層116として堆積される。スート層116は、スート層112と同一の、スート 層112より高い、又はスート層112より低い屈折率を有してよい。図2Aの2層クラ ッド領域を有するファイバのドロー形成を可能とするプリフォームを達成するためには、 例えばスート層112をアップドープシリカとしてよく、またスート層116をアップド ープシリカとしてよい。スート層116は、2層スートクラッドモノリスの外側層、又は 3つ以上の層を有するスートクラッドモノリスの中間層を構成してよい。 【0047】

図6は、スート層116上のスート層11400堆積を示す。スート層114は、スート 層112又はスート層116と同様の方法で形成できる。例えば、SiCl<sub>4</sub>又はオクタ メチルシクロテトラシロキサン(OMCTS)といった気相シリカ系ガラス前駆体材料を バーナ122に供給し、火炎126中で反応させて、シリカ系ガラススートを形成でき、 これは、ベイトロッドが回転するに従ってスート層116上にスート層114として堆積 される。スート層114は、スート層116若しくはスート層112と同一の、スート層 116若しくはスート層112より高い、又はスート層116若しくはスート層112よ り低い屈折率を有してよい。図2Bの3層クラッド領域を有するファイバのドロー形成を 可能とするプリフォームを達成するためには、例えばスート層112をアップドープシリ カとしてよく、スート層116をダウンドープシリカとしてよく、またスート層114を アップドープシリカとしてよい。スート層1144は、3層スートクラッドモノリスの外側 層、又は4つ以上の層を有するスートクラッドモノリスの中間層を構成してよい。追加の 層を同様に堆積させることによって、いずれの所望の数の層を有するスートクラッドモノ リスを得ることができる。

【0048】

多層スートクラッドモノリスの異なる複数の層を形成するために使用されるプロセス条件は、同一であっても異なっていてもよい。プロセス変数としては、火炎温度、ケイ素又はドーパントのための前駆体の流量、ベイト基材の長さに沿ったバーナの横断速度、及びベイト基材の回転速度が挙げられる。プロセス条件の変動によって、スートの堆積速度、及び堆積させたままの状態でのスートの密度を制御できる。火炎温度は、1500 以上であってよい。火炎温度が高いほど、堆積させたままのスートの密度を高くすることができる。反対に、火炎温度が低いほど、堆積させたままのスートの密度は低くなる。

スート密度は、ベイト基材に沿ったバーナの横断の速度によっても影響され得る。火炎の横断速度は、0.1 cm/秒超、又は0.25 cm/秒超、又は0.5 cm/秒超、又は1 cm/秒超、又は2 cm/秒超、又は3 cm/秒超であってよい。横断速度がより速いと、堆積させたままの状態において密度がより速いと、堆積させたままの状態において密度がより高く、多孔性がより低いスート層がもたらされ得る。堆積させたままの状態のスート層の密度は、1.0g/cm<sup>3</sup>未満であってよい。堆積させたままの状態のスート層の密度は、1.0g/cm<sup>3</sup> 未満であってよい。堆積させたままの状態のスート層の密度は、1.0g/cm<sup>3</sup>超、又は1.25g/cm<sup>3</sup>超、又は1.5g/cm<sup>3</sup>超、又は1.75g/cm<sup>3</sup>超、又は2.0g/cm<sup>3</sup>超であってよい。

【 O O 5 O 】

堆積させたままの状態のスート層密度は、バーナへのスート前駆体の送達速度によって <sup>50</sup>

30

も影響され得る。シリカ系スート前駆体の流量は、0.1L/分~20L/分の範囲内で あってよい。流量が低いほど、堆積させたままの状態において密度がより高いスート層の 形成が促進される。反対に、流量が高いほど、堆積させたままの状態において密度がより 低いスート層の形成が促進される。

【 0 0 5 1 】

堆積させたままの状態のスート層密度は、スート堆積中のベイトロッドの回転速度によっても影響され得る。ベイトロッドの回転速度を低下させることにより、堆積させたままの状態のスート層の密度の上昇を支援できる。反対に、ベイトロッドの回転速度を増大させることにより、堆積させたままの状態のスート層の密度の低下を支援できる。

【0052】

ー実施形態では、スートクラッドモノリスは2つのスート層を含み、ここで外側層は、 内側層よりも高い密度を有する。別の実施形態では、スートクラッドモノリスは3つのス ート層を含み、ここで中間スート層は、内側スート層と外側スート層との間に位置決めさ れ、上記中間スート層は、上記内側スート層よりも高い密度を有する。更に別の実施形態 では、スートクラッドモノリスは4つ以上のスート層を含み、ここで2つ以上の中間スー ト層が、内側スート層と外側スート層との間に位置決めされ、上記中間スート層のうちの 少なくとも1つは、上記内側スート層よりも高い密度を有する。

【0053】

所望の数及びタイプのスートクラッド層を堆積させた後、ベイトロッドを除去して、スートクラッドモノリスを提供する。ベイトロッドが占有していた空間は、スートクラッド <sup>20</sup> モノリスの内部キャビティを形成する。

【0054】

ケース・イン・スートプロセスでは、コアケーンをスートクラッドモノリスの内部キャ ビティに挿入して、コア クラッド組立体を形成する。 【0055】

図7は、固結炉130内へのスートクラッドモノリス110の配置を示す。スートクラ ッドモノリス110は、ベイトロッド120を除去した後の、図6に示す3層スート構造 体に対応し、上述のように一連の同心スート層112、116及び114を含む。スート クラッドモノリス110は更に、内部キャビティ118を含む。図7の実施形態では、内 部キャビティ118は、スートクラッドモノリス110の全長を通って延在する。他の実 施形態では、内部キャビティ118はスートクラッドモノリス110の内に、部分的にのみ 延在する。高密度化されたコアケーン102を内部キャビティ118に挿入して、コア クラッド組立体を形成する。コアクラッド組立体は、コアケーン102の外側表面とス ートクラッド層112の内側表面との間に間隙を含む。コアクラッド組立体を、固結炉 130内で加工する。

【0056】

コア クラッド組立体を、本明細書に記載の方法に従って加工して、光ファイバプリフ ォームを形成する。上述のように、この加工は固結を含み、コア クラッド組立体の1つ 以上の多孔性スートクラッド層のスート ガラス変換を実施する。加工は、予備加熱ステ ップ、中間加熱ステップ、及び焼結ステップを含んでよく、ここで上記予備加熱ステップ 、中間加熱ステップ、及び焼結ステップのうちの1つ以上は、還元剤によるスートクラッ ドプリフォームの処理を含んでよい。スートクラッドプリフォームの加工は、乾燥ステッ プ及びドープステップも含んでよい。

[0057]

加工が乾燥ステップを含む実施形態では、コア クラッド組立体を乾燥剤で処理する。 この乾燥ステップは、約800~1300の温度で実施してよく、上述の予備加熱ス テップ及び中間加熱ステップのうちの一方又は両方を含む。乾燥剤は、コア クラッド組 立体の多孔性スートクラッド層の細孔に浸透して、水又はOH基と反応し、多孔性スート クラッド層から水及びOH基を除去する。乾燥剤は、多孔性スートクラッド層中に存在し 得る遷移金属又は他の不純物も除去できる。 10

[0058]

図7を参照すると、乾燥剤は、流路132によって示されるように、コアケーン102 の外側表面とスートクラッド層112の内側表面との間の間隙に入ることができる。乾燥 剤は、スート層112、116及び114内の細孔にも入ることができ、また流路134 によって示されるように、スートクラッド層114の外側表面を取り囲む、又は上記外側 表面の周りを通過することもできる。コア クラッド組立体を通った、及び/又はコア クラッド組立体の周りの、乾燥剤の流量は、約1L/分~約40L/分の範囲内であって よい。コア クラッド組立体は、脱水中に加熱してよい。加熱は乾燥剤の作用を更に進め ることができ、ヒドロキシル及び水の除去を促進できる。

【0059】

脱水の温度は、約500 ~約1300 の範囲内としてよく、脱水の時間は、30分 ~10時間の範囲内としてよい。脱水の温度は好ましくは、コア クラッド組立体のスー トクラッドモノリス構成成分の焼結を開始するために必要な温度未満である。スートクラ ッドモノリスの不十分な焼結は、細孔を閉鎖し、スートクラッドモノリスの内部への脱水 剤のアクセスをブロックすることにより、ヒドロキシル及び水の除去を阻害する。乾燥剤 は、脱水が完了するとすぐに、スートクラッドモノリス及び/又はコア クラッド組立体 を取り囲む環境から除去してよい。

[0060]

好適な乾燥剤は、Cl<sub>2</sub>、SiCl<sub>4</sub>、GeCl<sub>4</sub>、SOCl<sub>2</sub>及び/又はPOCl<sub>3</sub> といった塩素含有ガスを含む。乾燥剤は任意に、He、Ar、Ne及び/又はN<sub>2</sub>といっ た不活性ガス中で希釈してよい。一実施形態では、脱水ガスは、ヘリウムガス中の2%~ 6%の塩素ガスの混合物を含む。いくつかの実施形態では、乾燥ガスは、約5体積%未満 の塩素、例えば約0.01~3.0体積%の塩素を含有する。

【0061】

いくつかの実施形態では、加工はドープステップを含んでよく、上記ドープステップで は、コア クラッド組立体をドーパント前駆体に曝露する。一実施形態では、ドープは、 スート ガラス変形プロセスの予備加熱ステップ中に実施される。別の実施形態では、ド ープは、中間加熱ステップ中に実施される。更に別の実施形態では、ドープは、スート ガラス変形プロセスの焼結ステップ中に実施される。ドープは好ましくは、コア クラッ ド組立体のクラッド層が、ドーパント又はドープ前駆体の拡散又は浸透が可能となるよう 十分に多孔性である間に行われる。一実施形態では、ドープは、脱水後かつ焼結前に行わ れる。

[0062]

ー実施形態では、ドープは、コア クラッド組立体内のコアケーンの外側表面とスート クラッドモノリスの内側表面との間の流路にドープ前駆体を供給することによって達成さ れる。例えば、ドープ前駆体を、図7に示す流路132に供給してよい。別の実施形態で は、ドープは、コア クラッド組立体のスートクラッドモノリス構成成分の外側スート層 の外側表面に隣接する流路にドープ前駆体を供給することによって達成される。例えば、 ドープ前駆体を、図7に示す流路134に供給してよい。

【0063】

ドープ前駆体を、コア クラッド組立体のスートクラッドモノリス構成成分の多孔性ス ート層に供給すると、ドープ前駆体は細孔に入って、スート層の表面へ、及び/又はスー ト層の内部全体にわたって、ドーパントを送達できる。ドープは、コア クラッド組立体 のスートクラッドモノリス部分の複数の層において行うことができる。

【0064】

コア クラッド組立体の焼結は、脱水後に行ってよい。乾燥剤及び/又はドーパント前 駆体は、焼結の開始前に、コア クラッド組立体の雰囲気から除去してよい。 【0065】

上記焼結は、スートクラッドモノリスを固結させ、スートクラッドモノリスとコアケー ンとを融合させて、固結済みファイバプリフォームを形成できる。焼結中、スートクラッ

10

20

ドモノリスの細孔が収縮し、スートクラッドモノリスが収縮してコアケーンに付着するため、高密度化が起こる。焼結温度は、少なくとも1300 、又は少なくとも1350 、又は少なくとも1400 、又は少なくとも1450 、又は少なくとも1500 で あってよい。焼結温度が高いほど、焼結の時間が削減される。

[0066]

焼結は、固結炉内での焼結を誘発するために十分な温度の高温領域を形成して、コア クラッド組立体を、温度が1400 ~約1500 の範囲であってよい炉内の熱サイク ルに曝露することにより、固結炉内で達成できる。コア クラッド組立体を焼結すること により、光ファイバプリフォームが製造される。図8は、図7のコア クラッド組立体を 焼結することによって形成された、光ファイバプリフォーム100を示す。上記光ファイ バプリフォームは、1つ以上の同心クラッド領域で取り囲まれた、1つ以上の同心領域を 有する中心コアを有する、ガラスの中実片である。

【0067】

光ファイバを、光ファイバプリフォームからドロー形成できる。固結済みガラスプリフ オームから光ファイバをドロー形成するための好適な技法及び装置は、当業者には公知で ある。上記固結済み光ファイバプリフォームの固結済みガラスコアは、光ファイバのコア (又はコアの一部)を形成することになり、上記固結済み光ファイバプリフォームの固結 済みクラッド層は、光ファイバのクラッド部分を形成することになることが理解されるだ ろう。

【0068】

ケーン・イン・スートプロセスで調製された光ファイバプリフォームの点検により、ド ロー中にプリフォームの破損につながり得る欠陥の存在が明らかになっている。欠陥は割 れを含み、これは、ファイバドロー形成のためにプリフォームを溶融するために必要な温 度までの再加熱プロセスの早期における、光ファイバプリフォームの破断につながり得る 。上述のように、ケース・イン・スートプロセスを用いた光ファイバプリフォームの製作 は、高温でのコア クラッド組立体の固結を含む。固結プロセスで形成された光ファイバ プリフォームは室温まで冷却され、ファイバドロー形成の時まで保管される。 【0069】

理論によって束縛されることを望むものではないが、固結温度から室温(又は他の比較 的低い温度)への光ファイバプリフォームの冷却が、光ファイバプリフォーム中の欠陥の 形成につながると考えられる。更に、欠陥は、コアケーン及びスートクラッドモノリスの 熱膨張係数の差異から発生する応力に起因するものと考えられる。上述のように、コアケ ーンは典型的にはアップドープシリカから形成され、クラッドは典型的には、非ドープシ リカ、又は非ドープシリカとダウンドープシリカとの組み合わせから形成される。コアケ ーン及びスートクラッドモノリスに使用される材料間に存在する組成の差異は、熱膨張係 数の差異を含意しており、これは、固結後の冷却中の、光ファイバプリフォームのコア及 びクラッド領域の収縮の速度又は程度の差異につながる。熱収縮の差異は、冷却中に、コ アケーンとスートクラッドモノリスとの間の界面に、応力を生成する。上記応力は、割れ 又は微小割れ等の欠陥を光ファイバプリフォーム内に形成するために十分なものであると 考えられる。

[0070]

冷却誘発型(cooling induced)欠陥の形成は、ケース・イン・スート プロセスにおいて、コア クラッド比が大きいコアケーンを用いて光ファイバプリフォー ムを形成する際に特に見られると予想される。コア クラッド比が大きいコアケーンでは 、アップドープ(高屈折率)領域の半径は、コアケーンの総半径の有意な部分を占める。 アップドープ領域の径方向範囲が大きいと、アップドープ領域の境界が、組成が一致しな いスートクラッド組立体の付近に位置決めされ、冷却中の光ファイバプリフォームのコア 及びクラッド領域の収縮の差異から発生する応力が増大する。例えばコア クラッド比が 1 である場合、コアはクラッドに直接隣接し、コアケーンとクラッドとの間の熱膨張係数 の差異が最もよく現れる。対照的に、コア クラッド比が小さいコアケーンを使用する場 10

20

30

合、アップドープ領域は、コアケーンとスートクラッドモノリスとの間の界面から除去さ れ、クラッドの熱膨張係数にかなり一致する非ドープ材料で取り囲まれる。その結果、収 縮によって発生する熱応力は比較的現れず、冷却時に形成される欠陥が少なくなる。 [0071]

(15)

図9(a)~(c)は、平坦な端部表面を有するコアケーンを用いてケース・イン・ス ートプロセスから形成された、光ファイバプリフォームを示す。図9(a)は、光ファイ バプリフォーム140を示す概略図である。光ファイバプリフォーム140は、コアケー ン145と、金属ハンドル155で支持された固結済みクラッド150とを含み、この金 属ハンドル155は、末端点151まで延在する。ハンドル155は、固結済みクラッド 150の内部キャビティ157への入口153を通過する。コアケーン145は内部キャ ビティ157内に位置し、内部キャビティ157の入口153に対面する平坦な端部表面 147を含む概ね円筒形の形状を有する。端部表面147とハンドル155の末端点15 1との間のヘッドスペースは、加工環境に存在する空気及び / 又は気体に占有される。ジ ャンクション159は、固結済みクラッド150と、コアケーン145と、ヘッドスペー ス149に存在する気体との間の3方向界面を構成する。 [0072]

図9(b)及び9(c)は、図9(a)に示されている概略図と同一の光ファイバプリ フォームの図を示す。プリフォームはケース・イン・スートプロセスで調製した。図9( b)に示す図は、固結後かつ冷却前の、昇温(1050 )時のプリフォームの画像であ る。図9(b)に示す画像は、冷却前、プリフォーム内に明らかな濃度の欠陥が存在しな いことを示す。図9(c)に示す画像は、室温まで冷却した後のプリフォームの画像であ る。図9(c)に示す画像は、冷却済みのプリフォーム中に欠陥(例えばチェック欠陥( check defect)又は「チェック(check)」)が存在することを示す。 チェック欠陥を有する光ファイバプリフォームを、ファイバのドロー形成のためにドロー 形成温度まで再加熱すると、光ファイバプリフォームは、欠陥から発生する剪断、割れの 伝播又は他の力によって破断し得る。破断は光ファイバプリフォームの破損につながり、 ドロー形成プロセスの中断を必要とする。

[0073]

光ファイバプリフォームの冷却中に進展する欠陥の原因は、プリフォームのコア及びク 30 ラッド領域の熱膨張係数の不一致によるものであると考えられる。上述のように、コアは 典型的にはアップドープシリカ材料であり、クラッドは典型的には、非ドープシリカ又は 非ドープシリカとダウンドープシリカとの組み合わせである。 Geは、コア領域のための ー般的なアップドーパントであり、GeドープSiO。の熱膨張係数は、非ドープシリカ 又はダウンドープシリカの熱膨張係数より有意に高いことが知られている。図10は、G eドープシリカ、非ドープシリカ及びFドープシリカに関する相対屈折率 %の関数とし て、100~500の温度間隔に亘る平均熱膨張係数を示す <sub>100-500</sub>を示す 。相対屈折率 %は、非ドープシリカに対する屈折率の尺度であり、ドープ濃度に比例す る。正の値の %はシリカのアップドープ形態を意味し、負の値の %はシリカのダウン % = 0は非ドープシリカに対応する。図10のために、Geをア ドープ形態を意味し、 ップドーパントとして含め、Fをダウンドーパントとして含める。図10は、Geドープ シリカの熱膨張係数が、Geドープ濃度の上昇と共に増大し、非ドープシリカ及びFドー プシリカ両方の熱膨張係数より高いことを示す。 [0074]

Geドープシリカについて、熱膨張係数(CTE)(単位:1/)及び %は: [0075]【数 2】

 $CTE = (5.05 + 0.42075[GeO_2]) \times 10^{-7}$ 

[0076]

及び

10

20

等式2

等式3

[0077]【数3】

 $\Delta\% = 0.055[GeO_2]$ 

[0078]

によって、GeO<sub>2</sub>濃度[GeO<sub>2</sub>](単位:重量%)に関連付けられる。 [0079]

図11は、Geドープシリカコア及び非ドープシリカクラッドを有する光ファイバプリ フォームの、等式2から算出された、室温での熱膨張係数の、半径に対する依存を示す。 Geドープシリカコアは、半径5mm及びコア クラッド比0.9である。Geドーパン ト分布は、コアの中線位置(r=0)において6.5重量%のピークドーパント濃度を有 し、r=4.5mmまで略平坦のままである、段階的屈折率プロファイルに従った。クラ ッドは、内径5mm及び外径65mmの非ドープシリカであった。クラッドはコアと直接 的に接触していた。図11は、熱膨張係数が、プリフォームのクラッド領域よりもコア領 域において有意に高いことを示す。コア領域のピーク熱膨張係数は8.42×10<sup>7</sup>/ であり、一方非ドープシリカの熱膨張係数は5.05×10<sup>7</sup>/ である。Geの濃度は 、コア領域の半径と共に減少するが、コアの径方向外側部分の熱膨張係数は、非ドープシ リカの熱膨張係数より明らかに高いままである。

(16)

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ 

図12は、室温への冷却後に、ケーン・イン・スートプロセスで作製した固結済みプリ 20 フォームの端部210において算出された径方向引張応力分布を示す。端部210は、コ アケーンの上部境界215付近の部分である。端部210は、コアケーン220及びクラ ッド240を含む。コアケーン220は円筒形であり、直径230が10mmである。コ アケーン220は、GeO,をドープしたシリカから作製され、コア クラッド比は0. 9 である。 G e O ,のドーププロファイルは、コアの中線位置( r = 0 )において6 .5 重量%のピークドーパント濃度を有し、r=4.5mmまで略平坦のままである、段階的 な屈折率である。GeO,-ドープシリカのコアケーンの熱膨張係数は、ドープ濃度の上 昇と共に増大する。コアケーン220のピーク熱膨張係数は、中線(r=0)位置におけ る7.97×10<sup>7</sup> / であり、r=4.5mmまで略平坦のままであり、その後r=4 .5mmで5.05×10<sup>7</sup>/ まで低下する。クラッド240は非ドープシリカから作 製され、内径が5mm、外径が65mmであった。クラッド240の、コアケーン220 付近の部分のみを図12に示す。クラッド240は環状であり、コアケーン220を取り 囲む。クラッド240の熱膨張係数は5.05×10<sup>7</sup>/ である。端部210はまた、 占有されていない空間250を含み、これにより、プリフォームの形成中にコアケーン2 20が軸方向に膨張できる。

[0081]

固結中のプリフォームの冷却中に進展する径方向引張応力を図12に示す。暗色の領域 は、径方向引張応力が低い領域であり、明色の領域は、径方向引張応力が高い領域である 。径方向引張応力が高い領域は、コアケーン220の中心のドープ部分、並びに円で囲ま れたコーナ領域225及び235に存在する。コアケーン220のドープされていない径 方向外側部分は、低い径方向引張応力を呈する。コーナ領域225及び235は、コアケ ーン220と、クラッド240と、占有されていない空間250内の上方の気体との間の 界面のジャンクションに存在する。上方の気体は、空気、プロセスガス、不活性ガス又は 他の気体であってよい。コーナ領域225及び235に存在する高い径方向引張応力は、 プリフォーム内に欠陥をもたらすと考えられ、これは、ドロー形成温度への再加熱時に破 断を引き起こす。

[0082]

図13は、図12に示したプリフォームに関するコーナ半径の関数として、算出された プリフォームのコーナ領域における径方向引張応力を示す。コーナ半径は、コアケーン2 20からクラッド240への遷移領域における端部210の表面の形状の尺度である。大 10



40

きなコーナ半径は、コアケーン220からクラッド240への界面を横断する、スムーズ で漸進的な遷移に対応し、その一方で小さなコーナ半径は、コアケーン220からクラッ ド240への界面を横断する、急峻で比較的不連続な遷移を意味する。図13は、径方向 引張応力が、コーナ半径の増大と共に減少することを示している。プリフォームの製造時 に典型的に使用される固結温度からの冷却速度の下では、プリフォームのコーナ半径は0 .1mm未満であり、0.01mm未満である場合もある。従って、コーナ領域における 径方向引張応力は高く、プリフォーム中の割れ又は他の欠陥の形成を誘発するのに十分な 大きさであると思われる。図14は、欠陥を有するコーナ領域(円で囲まれた領域)を有 する、Geドープシリカコアケーンの図である。

(17)

【 0 0 8 3 】

本開示は、ケース・イン・スートプロセスで作製された固結済みプリフォームの1つ以 上のコーナ領域における径方向引張応力を最小化するための戦略を提供する。この戦略は 、1つ以上のコーナ領域へのキャップの配置を含み、ここでキャッピング材料は、コアケ ーンの熱膨張係数より小さい熱膨張係数を有する。一実施形態では、コアケーンの熱膨張 係数はクラッドの熱膨張係数より大きく、一方キャップの熱膨張係数は、コアケーンの熱 膨張係数より小さく、かつクラッドの熱膨張係数より大きい。別の実施形態では、コアケ ーンの熱膨張係数は、クラッドの熱膨張係数より大きく、一方キャップの熱膨張係数は、 クラッドの熱膨張係数と等しい。更に別の実施形態では、コアケーンの熱膨張係数は、 クラッドの熱膨張係数と等しい。更に別の実施形態では、コアケーンの熱膨張係数より り大きく、かつクラッドの熱膨張係数より小さい。別の実施形態では、コアケーンの熱膨 張係数は、クラッドの熱膨張係数より小さく、一方キャップの熱膨張係数は、クラッドの 熱膨張係数とりい。

[0084]

コアケーンをスートクラッドモノリスの内部キャビティに挿入してコア クラッド組立 体を形成する前又は後に、1つ以上のキャップをコアケーンと一体化してよい。一体化さ れた1つ以上のキャップは、コアケーンに直接的に接触してよく、コアケーンにしっかり と接合されていてよく、又はコアケーンに間接的に接触してよい。一実施形態では、キャ ップは、コアケーンの製造中にコアケーンの端部に形成され、ケース・イン・スートプロ セスにおいて、キャッピング済みコアケーンをスートクラッドモノリスの内部キャビティ に挿入する。

キャップは、コアケーンの1つ以上の端部表面への直接堆積によって、又はコアケーンを スートクラッドモノリスと一体化してコア クラッド組立体を形成する前に、独立して形 成されたキャップをコアケーン上に融着することによって、コアケーン上に形成してよい 。コアケーンは、2つ以上の端部においてキャッピングしてよい。一実施形態では、コア ケーンは円筒形であり、一方又は両方の端部表面においてキャッピングされる。2つ以上 のキャップをコアケーンと一体化する場合、これらのキャップは、同一の若しくは異なる 組成、並びに/又は同一の若しくは異なるサイズ、形状及び/若しくは熱膨張係数を有し てよい。

[0085]

別の実施形態では、キャッピングされていないコアケーンをスートクラッドモノリスの 内部キャビティに挿入し、1つ以上のキャップも内部キャビティ内に配置する。1つ以上 のキャップは、コアケーンの1つ以上の端部表面上に直接配置してよい。あるいは、キャ ップを保持するため、又はプリフォームの形成プロセスにおけるコア クラッド組立体の 固結中にキャップとコアケーンとの一体化を促進するために、コアケーンの端部表面とキ ャップとの間に介在材料を配置してよい。介在材料は、フラックス材料又は接着材料であ ってよく、コアケーン及びキャッピング材料のうちの一方又は両方の組成と同一の又は異 なる組成を有してよい。介在材料は、固結されていてもいなくてもよい。一実施形態では 、介在材料は、未固結SiO2スート粉体である。別の実施形態では、介在材料はSiO 2スートペレットである。キャップとコアケーンとの融着及び一体化は、ケース・イン・ スートプロセスにおけるコア クラッド組立体からのプリフォームの形成中に発生する加 50

20

10

10

30

40

熱プロセス中に行われる。一実施形態では、キャップとコアケーンとの融着及び一体化は 、ケース・イン・スートプロセスの焼結及び / 又は固結プロセス中に行われる。 【 0 0 8 6 】

図15は、キャッピング済みコアケーン300を断面図で示す。キャッピング済みコア ケーン300は、コアケーン310、並びにキャップ305及び315を含む。コアケー ン310は円筒形であり、キャップ305及び315は、コアケーン310の端部表面に 位置決めされる。図15の実施形態では、キャップ305及び315は、端部表面上に直 接形成される。あるいは、キャップ305とコアケーン310との間、及び/又はキャッ プ315とコアケーン310との間に、介在材料(図示せず)を位置決めしてよい。キャ ップ305及び315は、コアケーン310と直接的に接触する。キャップ305及び3 15は、コアケーン310にしっかりと接合されていてよい。

【0087】

図16は、コアケーン310、キャップ305及びキャップ315からの、キャッピン グ済みコアケーン300の組み立てを示す。この実施形態では、コアケーン310、キャ ップ305及びキャップ315は独立して形成され、組み合わされてキャッピング済みコ アケーン300が形成される。キャップ305とコアケーン310との間、及び/又はキ ャップ315とコアケーン310との間に、介在材料(図示せず)を位置決めしてよい。 【0088】

図17は、コア クラッド組立体の形成を示す。キャッピング済みコアケーン300を 、スートクラッドモノリス330の内部キャビティ325に挿入して、コア クラッド組 <sup>20</sup> 立体335を形成する。スートクラッドモノリス330及びコア クラッド組立体335 は断面図で示されている。スートクラッドモノリス330は、環状の多孔性スート領域3 20内に内部キャビティ325を含む。キャッピング済みコアケーン300は例えば、図 15及び16に関連して上述した方法によって形成できる。上述のように、コアケーン3 10の端部表面とキャップ305との間、及び/又はコアケーン310の端部表面とキャ ップ315との間に、介在材料が含まれていてよい。

【0089】

図18は、コア クラッド組立体335を形成するための代替的な方法を示す。コアケ ーン310を、スートクラッドモノリス330の内部キャビティ325に挿入する。次に キャップ305及び315を、コアケーン310の端部表面に隣接して、内部キャビティ 325に挿入し、コア クラッド組立体335を形成する。上述のように、コアケーン3 10の端部表面とキャップ305との間、及び/又はコアケーン310の端部表面とキャ ップ315との間に、介在材料が含まれていてよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$ 

図19は、プリフォーム345を形成するための、コア クラッド組立体335の固結 を示す。プリフォーム345は、内部キャビティ325内にキャップ305及び315を 有するコアケーン310を含む。内部キャビティ325は、環状の固結済みスート領域3 40で取り囲まれる。固結済みスート領域340は、完全に高密度化されたガラスである 。上述のように、コアケーン310の端部表面とキャップ305との間、及び/又はコア ケーン310の端部表面とキャップ315との間に、介在材料が含まれていてよい。 【0091】

1つ以上のキャップは、コアケーンの断面寸法に概ね対応する断面寸法を有してよい。 例えばコアケーンが円筒形である場合、コアケーンの断面寸法は直径であり、1つ以上の キャップは、コアケーンの直径に一致するか又は概ね一致する直径を有する円筒形であっ てよい。コアケーン及び/又は1つ以上のキャップの断面はまた、スートクラッドモノリ スの内部キャビティの断面寸法にも概ね対応してよい。

【0092】

キャップの厚さは、キャップの断面寸法に対して垂直な方向である。本発明は予想外にも、

1つ以上のキャップによるプリフォーム中の欠陥の形成の抑制を、比較的薄い1つ以上の 50

キャップを用いた場合でさえ達成できることを発見した。図20は、キャップの高さ(厚 さ)の関数として、ケース・イン・スートプロセスで作製されたプリフォームのコーナ領 域(図12に示すコーナ領域225及び235等)における径方向引張応力の算出された 変動を示す。図20に示されている算出の基礎は、SiO2キャップを有するGeO2ド ープシリカコアケーンと、シリカスートクラッドモノリスとを有するコア クラッド組立 体を固結させることによって形成した、プリフォームである。GeO2ドープシリカコア ケーンは、直径10mm及びコア クラッド比0.9であった。SiO2は、GeO2ド ープシリカコアケーンの端部表面上に直接位置決めした。SiO2キャップは、直径10 mmであり、図20に示すように様々な高さ(厚さ)を有していた。プリフォームのコー ナ半径は0.2mmであった。

【0093】

図20に示されている結果は、径方向コーナ引張応力が、SiO<sub>2</sub>キャップの高さ(厚 さ)の増大と共に有意に減少することを示す。ゼロ高さ(厚さ)におけるデータ点は、キ ャッピングされていないコアケーンを有するプリフォームに対応する。SiO<sub>2</sub>キャップ を有しないプリフォームの径方向コーナ引張応力は、102MPaであった。径方向コー ナ引張応力は高さ(厚さ)が1mm、2mm及び5mmのSiO<sub>2</sub>キャップを含めること によって、それぞれ60MPa、51MPa及び17MPaまで減少した。径方向コーナ 引張応力の減少により、固結プロセス中の冷却時にプリフォーム中に欠陥が形成される可 能性が低減される。

【0094】

プリフォームのコーナ領域の径方向引張応力は、100MPa未満、又は80MPa未満、又は60MPa未満、又は30MPa未満、又は20MPa未満、又は10MPa未満、又は5MPa~100MPa、又は5MPa~80MPa、又は5MPa~60MPa、又は5MPa~30MPa、又は5MPa~20MPa、又は10MPa~60MPa、又は10MPa~50MPa、又は10MPa~40MPa、又は10MPa~30MPa、又は10MPa~20MPaであってよい。

【0095】

コアケーンに一体化されたキャップの高さ(厚さ)は、100mm未満、又は50mm 未満、又は25mm未満、又は10mm未満、又は5mm未満、又は3mm未満、又は1 mm未満、又は0.5mm~100mmの範囲、又は1.0mm~75mmの範囲、又は 2.0mm~60mmの範囲、又は5.0mm~50mmの範囲、又は8.0mm~40 mmの範囲、又は10mm~35mmの範囲であってよい。

【0096】

図21は、キャッピング済みコアケーンを含むコア クラッド組立体の固結によって作 製されるプリフォームの図である。プリフォームの上端におけるコアケーン及びキャップ の位置が記されている。コアケーンは、直径10mm及びコア クラッド比0.9のGe O<sub>2</sub>ドープシリカであった。キャップは、直径10mm及び高さ(厚さ)2mmの非ドー プシリカであった。キャップの上部表面には点線で印が付けられ、コーナ領域は円で囲ま れている。この図は、コーナ領域が本質的に欠陥を含まないことを示している。

【0097】

図22は、5mm厚のSiO2端部キャップでキャッピングされたGeO2ドープシリカコアケーンを有するコア クラッド組立体を固結させることによって作製されたプリフォームの、算出された径方向引張応力を示す。プリフォーム360は、10mmである直径362を有するGeO2ドープシリカコアケーン365と、シリカクラッド370と、高さ(厚さ)5mmのシリカ端部キャップ375とを含む。円で囲まれたコーナ領域380及び385は、占有されていない空間390の一部として示されている。径方向引張応力の大きさは着色によって示されており、暗色の着色は小さな径方向引張応力を意味し、明色の着色は大きな径方向引張応力を意味する。図20に示す径方向引張応力プロファイルは、端部キャップ375を含めることによって、コーナ領域380及び385の径方向引張応力が、図12に示されているキャッピングされていない類似物と比較して大幅に減

10



少することを示している。大きな径方向引張応力は、コアケーン365の内部ドープ領域 、及びコアケーン365の端部表面と端部キャップ375との間の界面に限定される。 【0098】

コアケーン上に1つ以上のキャップを含めることにより、コーナ領域380及び385 に関連付けられたコア クラッド 気体ジャンクションにおける径方向引張応力の進展が 緩和され、従って(例えば図21に示すように)プリフォーム内の欠陥の形成の可能性が 低減される。直径10mm及びコア クラッド比0.9のGeO2ドープシリカコアと、 シリカクラッドとを有するコア クラッド組立体から固結されたプリフォームに関する論 理モデルは、プリフォームの径方向コーナ引張応力が約80MPaであること、及びドロ ー形成中のプリフォームの破損の蓋然性(径方向コーナ引張応力が引き起こすプリフォー ム内の欠陥による、ドロー形成中のプリフォームの剪断の蓋然性)が約90%であること を示している。このモデルから、径方向コーナ引張応力を約45MPaまで低減できるこ と、及び1mm厚のSiO2キャップを含むことによって、破損の蓋然性を約3%まで低 減できることが予測される。2mm厚のSiO2キャップを用いると、径方向コーナ引張 応力は約32MPaまで低減され、破損の蓋然性は1%未満まで低減される。 【0099】

本開示から得られる径方向コーナ引張応力の低減により、固結プロセスにおけるプリフ オームの冷却中に欠陥を大きく進展させることなく、コア クラッド比が大きいコアケー ンからプリフォームを製造できる。コアのコア クラッド比は、0.30超、又は0.4 0超、又は0.50超、又は0.60超、又は0.70超、又は0.80超、又は0.8 5超、又は0.90超、又は0.95超、又は0.30~1.0の範囲、又は0.60~ 0.95の範囲、又は0.65~0.95の範囲、又は0.70~0.95の範囲、又は 0.75~0.95の範囲、又は0.80~0.95の範囲、又は0.60~0.90の 範囲、又は0.65~0.90の範囲、又は0.70~0.90の範囲、又は0.75~ 0.90の範囲、又は0.80~0.90の範囲であってよい。 【0100】

そうでないことがはっきりと言明されていない限り、本明細書に記載のいずれの方法が 、その複数のステップをある具体的な順序で実施することを要求するものとして解釈され ることは、全く意図されていない。従って、方法クレームが、その複数のステップが従う べき順序を実際に記載していない場合、又はそうでなくても、請求項若しくは本説明中に 、上記複数のステップがある具体的な順序に限定されることが具体的に言明されていない 場合、いずれの特定の順序が推定されることは全く意図されていない。

30

40

10

20

例示されている実施形態の精神又は範囲から逸脱することなく、様々な修正及び変形を 実施できることは、当業者には明らかであろう。例示されている実施形態の精神及び実質 を援用した、本開示の実施形態の修正、組み合わせ、部分的組み合わせ及び変形は、当業 者に想起され得るため、本説明は、添付の請求項及びその均等物の範囲内の全てを含むも のとして解釈されるものとする。

[0102]

以下、本発明の好ましい実施形態を項分け記載する。

[0103]

実施形態 1

多孔性スートクラッドモノリスであって、上記多孔性スートクラッドモノリスは、内部 キャビティを取り囲む第1の多孔性クラッドガラス層を含み、上記多孔性スートクラッド モノリスは、第1の熱膨張係数を有する第1の材料を含む、多孔性スートクラッドモノリ ス;

上記内部キャビティ内に位置決めされた部分を有する第1のガラス本体であって、上記 第1のガラス本体は、第2の熱膨張係数を有する第2の材料を含み、上記第2の熱膨張係 数は上記第1の熱膨張係数と異なる、第1のガラス本体;及び

上記内部キャビティ内に位置決めされた部分を有する第2のガラス本体であって、上記 50

第2のガラス本体は、第3の熱膨張係数を有する第3の材料を含み、上記第3の熱膨張係 数は上記第2の熱膨張係数と異なる、第2のガラス本体 を備える、コア クラッド組立体。 [0104]実施形態2 上記第1の材料はシリカを含む、実施形態1に記載のコア クラッド組立体。 [0105]実施形態3 上記第2の材料は、ドーパントを含有するシリカを含む、実施形態1又は2に記載のコ 10 ア クラッド組立体。 [0106]実施形態4 上記ドーパントはGeを含む、実施形態3に記載のコア クラッド組立体。 実施形態 5 上記第1のガラス本体は、少なくとも0.70のコア クラッド比を有する、実施形態 1~4のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体。 [0108]実施形態 6 20 上記第1のガラス本体は、少なくとも0.90のコア クラッド比を有する、実施形態 1~4のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体。 [0109]実施形態 7 上記第3の材料はシリカを含む、実施形態1~6のいずれか1つに記載のコア クラッ ド組立体。 [0110]実施形態 8 上記第2の材料は、上記第1の材料より高い屈折率を有する、実施形態1~7のいずれ か1つに記載のコア クラッド組立体。 30 [0111]実施形態 9 上記第3の材料は、上記第2の材料より低い屈折率を有する、実施形態1~8のいずれ か1つに記載のコア クラッド組立体。 実施形態10 上記第2の熱膨張係数は上記第1の熱膨張係数より大きい、実施形態1~9のいずれか 1つに記載のコア クラッド組立体。 [0113]実施形態11 上記第2の熱膨張係数は上記第3の熱膨張係数より大きい、実施形態1~10のいずれ 40 か1つに記載のコア クラッド組立体。 [0114]実施形態12 上記第3の熱膨張係数は、上記第1の熱膨張係数以上である、実施形態11に記載のコ ア クラッド組立体。 [0115]実施形態13 上記内部キャビティは更に、上記第1のガラス本体と上記第2のガラス本体との間に位

置決めされた介在する材料を含む、実施形態1~12のいずれか1つに記載のコア クラ

ッド組立体。

(21)

**[**0 1 1 6 **]** 

実施形態14

上記介在する材料はフラックスである、実施形態13に記載のコア クラッド組立体。 【0117】

実施形態15

上記第1のガラス本体及び上記第2のガラス本体は、上記内部キャビティ内で直接的に 接触する、実施形態1~14のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体。

[0 1 1 8 ]

実施形態16

上記第1のガラス本体及び上記第2のガラス本体は、上記内部キャビティ内でしっかり <sup>10</sup> と接合される、実施形態15に記載のコア クラッド組立体。

【0119】

実施形態17

上記第1のガラス本体は、上記内部キャビティ内に完全に内包される、実施形態1~1 6のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体。

[0120]

実施形態18

上記第2のガラス本体は、上記内部キャビティ内に完全に内包される、実施形態17に 記載のコア クラッド組立体。

[0121]

実施形態19

上記内部キャビティ内に位置決めされる第3のガラス本体を更に備え、

上記第3のガラス本体は、第4の熱膨張係数を有する第4の材料を含み、上記第4の熱 膨張係数は上記第2の熱膨張係数と異なる、実施形態17又は18に記載のコア クラッ ド組立体。

[0122]

実施形態20

上記第1のガラス本体は、上記内部キャビティ内において上記第2のガラス本体及び上 記第3のガラス本体に直接的に接触する、実施形態19に記載のコア クラッド組立体。

【0123】 実施形態21

30

20

上記第1のガラス本体は、上記内部キャビティ内において上記第2のガラス本体及び上 記第3のガラス本体としっかりと接合される、実施形態19に記載のコア クラッド組立 体。

[0124]

実施形態 2 2

上記第2のガラス本体の厚さは50mm未満であり、上記第3のガラス本体の厚さは50mm未満である、実施形態19~21のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体。

【 0 1 2 5 】

実施形態23

40

上記第2のガラス本体の厚さは1.0mm~75mmであり、上記第3のガラス本体の 厚さは1.0mm~75mmである、実施形態19~21のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体。

[0126]

実施形態24

上記第2のガラス本体の厚さは50mm未満である、実施形態1~21のいずれか1つ に記載のコア クラッド組立体。

**[**0 1 2 7 **]** 

実施形態25

上記第2のガラス本体の厚さは1.0mm~75mmである、実施形態1~21のいず 50

(22)

れか1つに記載のコア クラッド組立体。 [0128] 実施形態26 実施形態1~25のいずれか1つに記載のコア クラッド組立体を固結させることによ って形成される、製品。 [0129]実施形態27 光ファイバプリフォームであって、 上記光ファイバプリフォームは、クラッドで取り囲まれたキャッピング済みコアケーン 10 を備え、 上記キャッピング済みコアケーンは、コアケーンの第1の端部表面と接触する第1のキ ャップを備え、 上記コアケーンはドープシリカを含み、かつ少なくとも0.7のコア クラッド比を有 し、 上記プリフォームはコーナ領域を含み、 上記コーナ領域は、上記キャッピング済みコアケーンと、上記クラッドと、気体との間 の界面を含み、 上記コーナ領域は、100MPa未満の径方向引張応力を有する、光ファイバプリフォー ム。 20 [0130] 実施形態28 上記コアケーンはGeO 。ドープシリカを含む、実施形態27に記載の光ファイバプリ フォーム。 [0131]実施形態29 上記クラッドはシリカを含む、実施形態27又は28に記載の光ファイバプリフォーム [0132] 実施形態30 30 上記コアケーンは、少なくとも0.90のコア クラッド比を有する、実施形態27~ 29のいずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0133]実施形態31 上記第1のキャップはシリカを含む、実施形態27~30のいずれか1つに記載の光フ ァイバプリフォーム。 [0134] 実施形態32 上記コアケーンは、上記クラッドより高い熱膨張係数を有する、実施形態27~31の いずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 40 [0135] 実施形態33 上記コアケーンは、上記第1のキャップより高い熱膨張係数を有する、実施形態27~ 32のいずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0136]実施形態34 上記第1のキャップは、上記クラッドの熱膨張係数以上の熱膨張係数を有する、実施形 態27~33のいずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0137]実施形態35 上記キャッピング済みコアケーンは、上記コアケーンと上記第1のキャップとの間に位 50

置決めされた介在する材料を更に含む、実施形態27~34のいずれか1つに記載の光フ ァイバプリフォーム。 [0138]実施形態36 上記コアケーン及び上記第1のキャップは直接的に接触する、実施形態27~34のい ずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0139]実施形態37 上記キャッピング済みコアケーンは更に、上記コアケーンの第2の端部表面に接触する 10 第2のキャップを備える、実施形態27~36のいずれか1つに記載の光ファイバプリフ オーム。 [0140]実施形態38 上記第1のキャップの厚さは50mm未満であり、上記第2のキャップの厚さは50m m 未満である、実施形態 2.7~3.7のいずれか 1 つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0141]実施形態39 上記第1のキャップの厚さは1.0mm~75mmであり、上記第2のキャップの厚さ は1.0mm~75mmである、実施形態27~37のいずれか1つに記載の光ファイバ 20 プリフォーム。 [0142]実施形態40 上記第1のキャップの厚さは50mm未満である、実施形態27~37のいずれか1つ に記載の光ファイバプリフォーム。 [0143]実施形態41 上記第1のキャップの厚さは1.0mm~75mmである、実施形態27~37のいず れか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0144]30 実施形態42 上記コーナ領域は、60MPa未満の径方向引張応力を有する、実施形態27~41の いずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0145]実施形態43 上記コーナ領域は、30MPa未満の径方向引張応力を有する、実施形態27~41の いずれか1つに記載の光ファイバプリフォーム。 [0146]実施形態44 実施形態27~43のいずれか1つに記載の光ファイバプリフォームからドロー形成さ 40 れた、光ファイバ。 **[**0147**]** 実施形態45 多孔性スートクラッドモノリスであって、上記スートクラッドモノリスは第1の多孔性 ガラスクラッド層を含み、かつ内部キャビティを有する、多孔性スートクラッドモノリス を提供するステップ;及び キャッピング済みコアケーンを上記内部キャビティに挿入して、コア クラッド組立体 を形成するステップであって、上記キャッピング済みコアケーンは、コアケーンと接触す

る第1のキャップを含み、上記第1のキャップは、第1の熱膨張係数を有する第1の材料 を含み、上記コアケーンは、第2の熱膨張係数を有する第2の材料を含み、上記第2の熱

膨張係数は上記第1の熱膨張係数と異なる、ステップ

(24)

を含む、光ファイバの製造方法。 [0148]実施形態46 上記第1の多孔性ガラスクラッド層はシリカを含む、実施形態45に記載の方法。 [0149]実施形態47 上記第2の材料はドープシリカを含む、実施形態45又は46に記載の方法。 [0150] 実施形態48 10 上記ドープシリカはGeO,ドープシリカを含む、実施形態45~47のいずれか1つ に記載の方法。 [0151]実施形態49 上記コアケーンは、少なくとも0.7のコア クラッド比を有する、実施形態45~4 7のいずれか1つに記載の方法。 **[**0152**]** 実施形態50 上記コアケーンは、少なくとも0.9のコア クラッド比を有する、実施形態45~4 7のいずれか1つに記載の方法。 20 [0153] 実施形態51 上記第1の材料はシリカを含む、実施形態47~50のいずれか1つに記載の方法。 [0154]実施形態52 上記第2の熱膨張係数は、上記第1の熱膨張係数より高い、実施形態45~51のいず れか1つに記載の方法。 [0155]実施形態53 上記第1の熱膨張係数は、上記第1の多孔性ガラスクラッド層の熱膨張係数より大きい 30 、実施形態52に記載の方法。 [0156] 実施形態54 上記コア クラッド組立体を加熱するステップを更に含む、実施形態45~53のいず れか1つに記載の方法。 **[**0157**]** 実施形態55 上記加熱するステップは、上記コア クラッド組立体を焼結させる、実施形態54に記 載の方法。 [0158] 40 実施形態56 上記加熱するステップは、上記コア クラッド組立体を固結させる、実施形態54に記 載の方法。 [0159] 実施形態57 上記コア クラッド組立体からファイバをドロー形成するステップを更に含む、実施形 態56に記載の方法。 [0160] 実施形態58 上記加熱するステップは、少なくとも900の温度で行われる、実施形態54に記載 50 の方法。

(25)

**[**0161**]** 

実施形態 5 9

上記加熱するステップは、少なくとも1300 の温度で行われる、実施形態54に記載の方法。

(26)

**[**0162**]** 

実施形態60

上記コア クラッド組立体を乾燥剤に曝露するステップを更に含む、実施形態54~5 9のいずれか1つに記載の方法。

[0163]

実施形態61

10

20

30

上記コア クラッド組立体を還元剤に曝露するステップを更に含む、実施形態54~6 0のいずれか1つに記載の方法。

[0164]

実施形態62

上記キャッピング済みコアケーンは、上記コアケーンに接触する第2のキャップを含み

上記第2のキャップは、第3の熱膨張係数を有する第3の材料を含み、上記第3の熱膨 張係数は上記第2の熱膨張係数と異なる、実施形態45~61のいずれか1つに記載の方 法。

【0165】

実施形態63

上記コアケーンは、上記第1のキャップと上記第2のキャップとの間にある、実施形態 62に記載の方法。

【0166】

実施形態64

上記第3の熱膨張係数は上記第2の熱膨張係数未満であり、

上記第1の熱膨張係数は上記第2の熱膨張係数未満である、実施形態63に記載の方法

【0167】

実施形態65

上記第1のキャップは上記コアケーンに直接的に接触する、実施形態45~64のいず れか1つに記載の方法。

【0168】

実施形態66

上記スートクラッドモノリスは第2の多孔性ガラスクラッド層を含み、

上記第2の多孔性ガラスクラッド層は上記第1の多孔性ガラスクラッド層を取り囲む、 実施形態45~65のいずれか1つに記載の方法。

【0169】

実施形態67

多孔性スートクラッドモノリスを提供するステップであって、上記スートクラッドモノ <sup>40</sup> リスは第1の多孔性ガラスクラッド層を含み、内部キャビティを有する、ステップ;

第1のキャップを上記内部キャビティに挿入するステップであって、上記第1のキャッ プは、第1の熱膨張係数を有する第1の材料を含む、ステップ;及び

コアケーンを上記内部キャビティに挿入するステップであって、上記コアケーンは、第 2の熱膨張係数を有する第2の材料を含み、上記第2の熱膨張係数は上記第1の熱膨張係 数と異なる、ステップ

を含む、光ファイバを製造する方法。

[0170]

実施形態68

上記第1の多孔性ガラスクラッド層はシリカを含む、実施形態67に記載の方法。

【0171】

実施形態 6 9

上記第2の材料はドープシリカを含む、実施形態67又は68に記載の方法。

【 0 1 7 2 】

実施形態70

上記ドープシリカはGeO2ドープシリカを含む、実施形態いずれか1つ69に記載の方法。

(27)

[0173]

実施形態71

上記コアケーンは、少なくとも0.7のコア クラッド比を有する、実施形態67~7 <sup>10</sup> 0のいずれか1つに記載の方法。

**[**0174**]** 

実施形態72

上記コアケーンは、少なくとも0.9のコア クラッド比を有する、実施形態67~7 0のいずれか1つに記載の方法。

**[**0175**]** 

実施形態73

上記第1の材料はシリカを含む、実施形態67~72のいずれか1つに記載の方法。

[0176]

実施形態74

上記第2の熱膨張係数は、上記第1の熱膨張係数より高い、実施形態67~73のいず れか1つに記載の方法。

【0177】

実施形態75

上記第1の熱膨張係数は、上記第1の多孔性ガラスクラッド層の熱膨張係数より大きい 、実施形態67~74のいずれか1つに記載の方法。

【0178】

実施形態76

上記コア クラッド組立体を加熱するステップを更に含む、実施形態67~75のいず れか1つに記載の方法。 30

【0179】

実施形態77

上記加熱するステップは、上記コア クラッド組立体を焼結させる、実施形態76に記載の方法。

【 0 1 8 0 】

実施形態78

上記加熱するステップは、上記コア クラッド組立体を固結させる、実施形態76に記載の方法。

[0181]

実施形態79

上記コア クラッド組立体からファイバをドロー形成するステップを更に含む、実施形 態78に記載の方法。

【0182】

実施形態 8 0

上記加熱するステップは、少なくとも1300 の温度で行われる、実施形態76に記載の方法。

【0183】

実施形態 8 1

上記加熱するステップは、少なくとも1400 の温度で行われる、実施形態76に記載の方法。

40

上記コア クラッド組立体を乾燥剤に曝露するステップを更に含む、実施形態67~8 1のいずれか1つに記載の方法。 上記コア クラッド組立体を還元剤に曝露するステップを更に含む、実施形態67~8 2のいずれか1つに記載の方法。 第2のキャップを上記内部キャビティに挿入するステップを更に含み、 上記第2のキャップは、第3の熱膨張係数を有する第3の材料を含み、上記第3の熱膨 張係数は上記第2の熱膨張係数と異なる、実施形態67~83のいずれか1つに記載の方

- 法。
- **[**0 1 8 7 **]**

[0184]実施形態82

**[**0 1 8 5 **]** 実施形態83

[0186]

実施形態84

実施形態85

上記第1のキャップは、上記内部キャビティの第1の端部に挿入され、

上記第2のキャップは、上記内部キャビティの第2の端部に挿入される、実施形態84 に記載の方法。

(28)

[0188]

実施形態86

上記コアケーンは、上記第1のキャップと上記第2のキャップとの間に挿入される、実 施形態85に記載の方法。

[0189]

実施形態87

上記第3の熱膨張係数は上記第2の熱膨張係数未満であり、

上記第1の熱膨張係数は上記第2の熱膨張係数未満である、実施形態84~86のいず れか1つに記載の方法。

[0190]

実施形態88

30

40

10

20

実施形態いずれか1つ実施形態 上記スートクラッドモノリスは第2の多孔性ガラスクラ ッド層を含み、

上記第2の多孔性ガラスクラッド層は上記第1の多孔性ガラスクラッド層を取り囲む、 実施形態67~87のいずれか1つに記載の方法。

【符号の説明】

[0191]

8	コアスートプリフォーム	
1 0	コア	
11a、	11b 光ファイバ	
12a	内側クラッド	
12b	外側クラッド	
1 2 t	トレンチ領域	
13	ハンドル	
100、	140 光ファイバフリフォーム	
100、 102、	1 4 0 光ファイバフリフォーム 1 4 5 、2 2 0 、3 1 0 コアケーン	
1 0 0、 1 0 2、 1 1 0	1 4 0 光ファイバブリフォーム 1 4 5 、 2 2 0 、 3 1 0 コアケーン スートクラッドモノリス	
1 0 0、 1 0 2、 1 1 0 1 1 2	1 4 0 光ファイバフリフォーム 1 4 5 、 2 2 0 、 3 1 0 コアケーン スートクラッドモノリス シリカ系スート層、スートクラッド層	
1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 4	1 4 0 光ファイバフリフォーム 1 4 5 、 2 2 0 、 3 1 0 コアケーン スートクラッドモノリス シリカ系スート層、スートクラッド層 スート層、スートクラッド層	
1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 4 1 1 6	1 4 0 光ファイバブリフォーム 1 4 5、 2 2 0、 3 1 0 コアケーン スートクラッドモノリス シリカ系スート層、スートクラッド層 スート層、スートクラッド層 スート層	

120 ベイトロッド 122 バーナ 124 ベイトロッド120の軸方向長さ 126 火炎 128 シリカ系ガラススート 1 3 0 固結炉 132 流路 134 流路 147 端部表面 149 ヘッドスペース 150 固結済みクラッド 151 末端点 153 内部キャビティ157の入口 155 金属ハンドル 159 ジャンクション 210 端部 215 上部境界 225、235、380、385 コーナ領域 コアケーン220の直径 230 240 クラッド 250 占有されていない空間 300 キャッピング済みコアケーン 305、315 キャップ 320 多孔性スート領域 330 スートクラッドモノリス 335 コア クラッド組立体 340 固結済みスート領域 345、360 プリフォーム 362 GeO<sub>2</sub>ドープシリカコアケーン365の直径 G e O <sub>2</sub> ドープシリカコアケーン 365 370 シリカクラッド 375 シリカ端部キャップ 390 占有されていない空間

10

20

【図18】

Figure 1A























【図5】



【図7】



【図8】







【図9(b)】



(b)

【図9(c)】













【図14】









【図18】

Figure 18





Figure 17





【図19】



Figure 19

【図20】











フロントページの続き

(72)発明者 フィオーディマルヴァ,ドミニク
アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 28411 ウィルミントン クリーク リッジ ロード
6704

審查官 有田 恭子

(56)参考文献 特表 2 0 1 3 - 5 1 2 8 5 1 (JP, A) 特開昭 6 2 - 1 7 1 9 3 3 (JP, A) 特開昭 6 0 - 2 4 7 7 3 4 (JP, A) 特開昭 6 0 - 2 6 4 3 4 1 (JP, A) 特開昭 6 2 - 2 1 6 9 3 3 (JP, A) 特開昭 0 7 - 1 9 6 3 3 2 (JP, A) 特開平 0 7 - 1 9 6 3 3 2 (JP, A) 特開平 0 2 - 5 0 1 8 7 1 (JP, A) 特開平 0 2 - 2 3 3 5 2 9 (JP, A) 特開昭 6 0 - 2 6 0 4 3 2 (JP, A) 特開昭 5 9 - 1 9 7 0 0 1 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C03B 37/00-37/16